

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 7 月 7 日(07.07.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/080992 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/023 (2006.01) *G03F 7/075* (2006.01)
C08G 73/10 (2006.01) *H01L 21/027* (2006.01)
C08G 73/22 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/071888
- (22) 国際出願日: 2010 年 12 月 7 日(07.12.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-296800 2009 年 12 月 28 日(28.12.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮部倫次 (MIYABE, Tomotsugu) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 藤田陽二 (FUJITA, Yoji) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POSITIVE-TYPE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: ポジ型感光性樹脂組成物

(57) Abstract: Disclosed is a positive-type photosensitive resin composition which has excellent storage stability, particularly excellent sensitivity stability, and can be formed into a cured film having excellent adhesion onto a substrate when heated at 350°C or higher or heated in the air. The positive-type photosensitive resin composition comprises (a) a polymer having, as the main component, at least one structure selected from the group consisting of a polyimide precursor structure, a polybenzoxazole precursor structure, and a polyimide structure, (b) a quinonediazide compound, (c) a silane coupling agent having a styryl group, (d) a silane coupling agent having an epoxy group, an oxetanyl group, a methacryloxy group, an acryloxy group, an amino group, an amide group or mercapto group and an alkoxysilyl group, and (e) a solvent.

(57) 要約: 保存安定性、特に感度安定性に優れ、350°C以上の高温加熱処理後、または空気中での加熱処理後の基板との密着性に優れた硬化膜を形成することのできるポジ型感光性樹脂組成物を提供すること。(a) ポリイミド前駆体構造、ポリベンゾオキサゾール前駆体構造、およびポリイミド構造よりなる群から選ばれる少なくとも1種の構造を主成分とするポリマー、(b) キノンジアジド化合物、(c) スチリル基を有するシランカップリング剤、(d) エポキシ基、オキセタニル基、メタクリロキシ基、アクリロキシ基、アミノ基、アミド基またはメルカプト基と、アルコキシシリル基とを有するシランカップリング剤および(e) 溶剤を含有するポジ型感光性樹脂組成物。

WO 2011/080992 A1